证券代码：301566　　证券简称：达利凯普　　公告编号：2026-044

大连达利凯普科技股份公司

关于公司高端电子元器件产业化二期项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）中长期发展战略规划，为进一步提升公司产能规模、优化产品结构、满足下游市场需求，公司拟利用现有厂区预留土地投资新建厂房、部分配套设施及设备。项目具体情况如下：

一、投资概述

（一）项目名称

公司高端电子元器件产业化二期项目。

（二）投资金额及资金来源

项目预计总投资为不超过人民币 1.2 亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。

（三）投资主体

大连达利凯普科技股份公司。

（四）项目建设地点

辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号。

（五）项目建设内容

项目建筑为 5#生产厂房，用于陶瓷电容的生产。

（六）项目建设周期

预计项目开始施工后建设期 2 年，最终以实际建设情况为准。

二、本次投资的目的

基于行业发展趋势与公司战略需要，开展本项目建设，有利于公司在行业需求上升期扩充产能，保障对客户的稳定供应，并为新产品的开发储备技术能力。

三、存在的风险

（一）本项目预估投资金额较大，未来可能会导致公司现金流减少，同时投资建设过程中相关政策的变化，可能使公司承担一定的财务风险。

（二）本投资是基于公司战略发展需要及对市场前景的判断，但是行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

（三）本投资项目具有一定建设周期，因此可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化等风险，导致投资后项目不能实现预期收益，项目的具体建设计划、内容可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需求等具体情况作相应调整。

四、对公司的影响

本次对外投资资金来源为自有资金或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。

五、审议事项

本次投资事项已经董事会审议通过，董事会授权董事长或由董事长授权的管理层据项目实际情况具体组织实施，并签署相关法律文件、办理相关手续。

六、其他说明

（一）关联交易说明

本次投资项目实施主体为公司自身，不涉及关联交易，不构成关联交易事项。

（二）重大资产重组说明

本次投资为公司固定资产投资项目，不涉及重大资产重组事项。

特此公告。

大连达利凯普科技股份公司董事会

2026 年 10 月 30 日